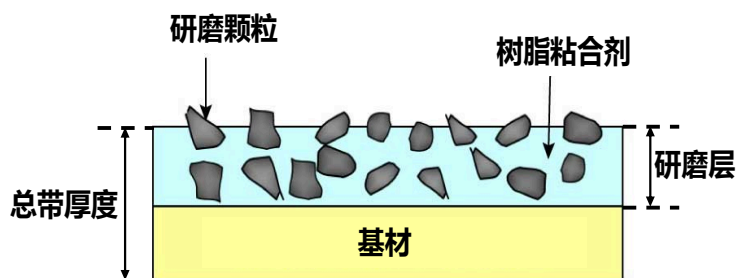


Wafer Lapping Film

高质量晶圆抛光带



碳化硅氮化镓研磨

卓越分散涂层技术

晶圆边缘研磨抛光

第一代



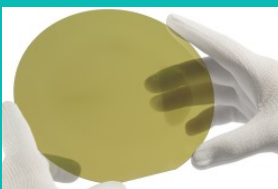
Si Ga

第二代



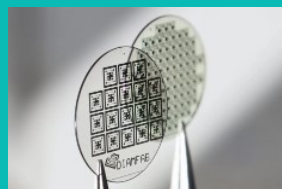
**GaAs InP
LT LN**

第三代



**SiC
GaN**

第四代



**Ga₂O₃
Diamond**

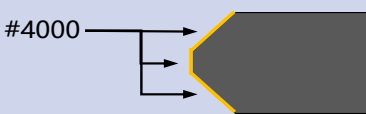
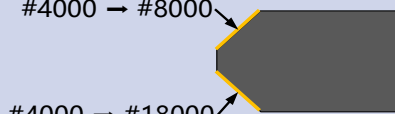
基本规格

项目	分类	尺寸
磨料	氧化铝	0.2-30 μ m
	碳化硅	0.5-30 μ m
	金刚石	0.1-9 μ m
基材	PET材质	25 μ m或75 μ m
形状	薄片状, 带状	

产品系列

目数	粒度 平均粒径 d50(μ m)	磨料		
		金刚石	碳化硅	氧化铝
26000	0.1	0		0
23000	0.2	0		0
15000	0.5	0	0	0
10000	0.8	0	0	0
8000	1	0	0	0
6000	2	0	0	0
4000	3	0	0	0
3000	5	0	0	0
2000	9	0	0	0
1500	10		0	0
600	30		0	0

加工案例

碳化硅 晶圆案例	抛光前	#4000抛光	#8000抛光 #18000抛光
晶圆端面 形状			
晶圆端面 显微镜图	